

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Sebelumnya	4
2.2 Pelapisan Logam Secara Listrik (<i>Electroplating</i>)	4
2.3 Elemen Sel Elektrolitik	6
2.3.1 Elektrolit (<i>Electrolit</i>)	6
2.3.2 Pengaliran Arus	6
2.3.3 Elektrolisis dan Ionisasi	7
2.3.4 Elektroda	8
2.4 Reaksi Reduksi dan Oksidasi	9
2.5 Mekanisme Reaksi	11
2.6 Pembersihan Kotoran (<i>Pickling</i>)	12
2.7 Macam-macam Electroplating	13
2.8 Tembaga (<i>Cu</i>)	13
2.9 Krom (<i>Cr</i>)	14
2.10 Baja	15
2.11 Rencana Benda Kerja	16
2.12 Ketebalan Lapisan	17
2.13 Temperatur Pelapisan	18
2.12.1 Energi Aktivasi	19

2.14 Pengujian Ketebalan Lapisan	20
2.15 Hipotesa.....	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	21
3.2 Variabel Penelitian.....	21
3.2.1 Variabel Bebas	21
3.2.2 Variabel Terikat	21
3.2.3 Variabel Terkontrol	21
3.3 Bahan dan Peralatan Yang Digunakan	22
3.3.1 Bahan	22
3.3.2 Peralatan.....	22
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.5 Prosedur Penelitian	28
3.6 Metode Pengukuran Data.....	29
3.7 Metode Pengolahan Data.....	29
3.8 Diagram Alir Penelitian	31

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Data Berat Pelapisan	33
4.1.2 Pengukuran Ketebalan Lapisan.....	35
4.2 Analisa Grafik dan Pembahasan.....	38
4.2.1 Grafik Pengaruh Temperatur Larutan Terhadap Ketebalan Lapisan	38

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN